# 不同 $SnO_2$ 含量的 $Ag-SnO_2$ 触头材料电弧侵蚀行为

## 任维佳,王献辉,张 苗,杨晓红,邹军涛

(西安理工大学, 陕西 西安 710048)

摘要:采用粉末冶金法制备了不同 SnO<sub>2</sub>含量的 Ag-SnO<sub>2</sub>触头材料,研究了 SnO<sub>2</sub>含量对 Ag-SnO<sub>2</sub>触头材料电弧侵蚀
行为的影响。使用扫描电子显微镜(SEM)表征了 Ag-SnO<sub>2</sub>触头材料电弧侵蚀形貌,对影响 Ag-SnO<sub>2</sub>触头材料电弧侵
蚀的因素进行了分析。结果表明,在电弧侵蚀过程中侵蚀优先发生在 SnO<sub>2</sub>区域。随 SnO<sub>2</sub>含量增多,燃弧时间依次增加,侵蚀面积逐渐减小,侵蚀坑变深,金属喷溅增强。
关键词: Ag-SnO<sub>2</sub>触头材料;粉末冶金;侵蚀形貌;电弧侵蚀
中图法分类号: TG146.3<sup>+</sup>2; TM241.1
文献标识码: A
文章编号: 1002-185X(2016)08-2075-05

作为开关电器的核心元件,电触头性能的好坏直接 影响着电器系统的可靠性、稳定性和使用寿命<sup>[1,2]</sup>。尽 管 Ag-CdO 触头材料具有优异的抗电弧侵蚀性、抗熔焊 性和较低的接触电阻,但镉对环境有害。Ag-SnO2触头 材料由于具有良好的综合性能,逐步成为 Ag-CdO 的替 代材料<sup>[3,4]</sup>。迄今为止,对 Ag-SnO<sub>2</sub>触头材料的制备工 艺和性能进行了大量研究<sup>[5-9]</sup>,但对电弧侵蚀机理还缺 乏清晰的认识和理解。目前对电弧侵蚀产生的原因不同 研究者从不同的角度进行了解释。郭凤仪等[10]认为 Ag-SnO<sub>2</sub> 触头材料电弧侵蚀机理主要由表面动力学特 性决定。堵永国<sup>[11]</sup>认为 Ag-SnO<sub>2</sub> 触头材料电弧侵蚀性 能的好坏取决于材料中各组分的热力学性质,在电弧作 用下 Ag-SnO<sub>2</sub> 触头表面熔化区域表层的成分、状态、 形貌特征及电弧对熔池的动力响应。V. Ćosović<sup>[12]</sup>及王 俊勃等<sup>[13]</sup>认为 SnO<sub>2</sub>颗粒在 Ag 基体中的分散程度是影 响 Ag-SnO<sub>2</sub> 触头材料电弧侵蚀性能的重要因素。王海 涛和朱艳彩等<sup>[14,15]</sup>认为 Ag 与 SnO<sub>2</sub> 润湿性差,易形成 液态喷溅,导致差的抗电弧侵蚀性能。张昆华[16]认为 触头材料的侵蚀性能取决于触点材料的材质、接触压 力、电流和电压的大小,电弧和使用环境等多种物理参 数。刘方方等<sup>[17]</sup>认为在电弧的高温作用下,触点表面 形成的熔池中心和边缘温度分布不均匀性使材料转移 方式发生变化,造成表面的电弧侵蚀。Swingler<sup>[18]</sup>发现 材料的元素与电弧侵蚀有一定相关性。Weaver 等<sup>[19]</sup>建 立了短路电弧热焓变化侵蚀模型揭示了材料的热力学 性质对触头侵蚀的影响,但该模型只适用于触头材料全 部以蒸发气化的侵蚀方式。Kharin 等<sup>[20]</sup>建立的把电弧 能量与电路特性联系起来的电弧侵蚀模型,阐明了侵蚀 量与材料性质参数之间的关系及负载特性对侵蚀的影 响。但也仅考虑了蒸发侵蚀,没有考虑喷溅侵蚀。吴细 秀等<sup>[21]</sup>建立了基于能量涨落的喷溅侵蚀模型和基于概 率统计的喷溅侵蚀模型,认为喷溅是熔池动能与表面张 力束缚能相互竞争的结果。

尽管这些研究对电弧侵蚀过程和侵蚀机理的理解 起到了积极的作用,但不同程度上都具有一定的局限 性,尚不能清楚解释电弧侵蚀机理。因此,有必要深入 研究电弧侵蚀与触头材料内在本质之间的关系。由于材 料组织决定了触头材料的性能,耐电弧侵蚀性能与氧化 物含量密不可分,本实验采用粉末冶金法制备了不同 SnO<sub>2</sub>含量的 Ag-SnO<sub>2</sub>触头材料,系统研究了 SnO<sub>2</sub>含量 对 Ag-SnO<sub>2</sub>触头材料的电弧侵蚀行为的影响。

### 1 实 验

实验原材料是 Ag 粉(粒度≤73 μm,纯度 99.9%) 和 SnO<sub>2</sub> 粉(粒度约 8 μm,纯度 99.0%)。首先分别 将 Ag 粉和质量分数为 2%、4%、6%和 8%的 SnO<sub>2</sub> 粉末分别在 V型混料机上混粉 6 h,使用无水乙醇作 过程控制剂;然后将复合粉末压制成 Φ15 mm×7 mm 的试样,最后在 Ar 气氛保护的真空管式炉内 700 ℃ 烧结 2 h。电弧侵蚀实验在 TDR-40A 单晶炉改造的真 空电击穿装置进行。将抛光后的试样放在阴极载物台 (Cu 台)上,阳极为半径 5 mm、头部半径 1 mm 的

收稿日期: 2015-08-10

**基金项目**:国家自然科学基金(51274163);陕西省重点实验室科技计划 (13JS076);国家留学基金(CSC);陕西省重点学科项目专项资金 (2011HBSZS009)

作者简介: 任维佳, 女, 1990 年生, 硕士生, 西安理工大学材料科学与工程学院, 陕西 西安 710048, 电话: 029-82312185, E-mail: renweijiaxaut@163.com

W 针。真空度为 5.0×10<sup>-3</sup> Pa,在电极两端加电压到 3.5 kV,使阴极以 0.2 mm/min 的速度接近阳极,直 至放电。反复进行 50 次,用 TDS-2014 型示波器记 录每次电弧作用后的燃弧时间。电弧侵蚀形貌采用 JSM-6700F 场发射扫描电子显微镜进行观察,使用 Image-Pro Plus 6.0 软件对侵蚀面积进行统计。

## 2 结果与分析

#### 2.1 Ag-SnO<sub>2</sub>触头材料显微组织

图 1 为不同 SnO<sub>2</sub>含量的 Ag-SnO<sub>2</sub>触头材料的显 微组织。图中白色区域是银基体,黑色细小颗粒为 SnO<sub>2</sub>。从图 1a 可以看出, SnO<sub>2</sub>含量为 2%时,组织中 出现少量 SnO<sub>2</sub>团聚,但 SnO<sub>2</sub>整体分布比较均匀。随 着 SnO<sub>2</sub>含量增加,SnO<sub>2</sub>颗粒团聚现象越来越明显,见图 1b 和 1c。当 SnO<sub>2</sub>含量为 8%时,SnO<sub>2</sub>颗粒在基 体中的团聚最为严重,如图 1d 所示。

#### 2.2 Ag-SnO2 触头材料燃弧时间

图 2a~图 2d 分别是 SnO<sub>2</sub>含量为 2%、4%、6%和 8%的 Ag-SnO<sub>2</sub>触头材料 50次电弧侵蚀后的燃弧时间分 布情况。可以看出,当 SnO<sub>2</sub>含量为 2%时,Ag-SnO<sub>2</sub>触头材料的燃弧时间波动最小,相对平稳,平均燃弧时间为 15.62 ms。与 Ag-2%SnO<sub>2</sub> 相比,含 4%SnO<sub>2</sub>的 Ag-SnO<sub>2</sub>触头材料电弧持续时间波动幅度较小,平均燃 弧时间为 16.69 ms。而当 SnO<sub>2</sub>含量为 6%时,Ag-SnO<sub>2</sub>触头材料前 20次燃弧时间波动较大,后期波动逐渐变 缓,平均燃弧时间 18.58 ms。当 SnO<sub>2</sub>含量增加到 8%时,Ag-SnO<sub>2</sub>触头材料的电弧持续时间最长,随着操作 次数的增加波动最为明显,平均燃弧时间为 19.90 ms。以上结果表明,随着 SnO<sub>2</sub>含量增加,Ag-SnO<sub>2</sub>触头材



图 1 不同 SnO<sub>2</sub>含量 Ag-SnO<sub>2</sub>触头材料的显微组织 Fig.1 Microstructures of Ag-SnO<sub>2</sub> contact materials with different SnO<sub>2</sub> contents: (a) 2%, (b) 4%, (c) 6%, and (d) 8%

料的电弧持续时间明显增加,波动幅度也相应变大。具 体原因可分析如下:当SnO2在基体中分散比较均匀时, Ag-SnO<sub>2</sub>触头材料在初始的几次电弧作用下,材料表面 破坏较小,因而燃弧时间比较接近。但随着电弧侵蚀次 数增加,电弧产生大量的热,导致 Ag-SnO<sub>2</sub> 触头材料 温度上升,引起大量的 Ag 的熔融与凝固,造成表面的 劣化,使材料的燃弧时间发生波动且电弧持续时间增 大。当 SnO2 含量为 2%时, SnO2 颗粒在 Ag 基体中分 散较好, SnO<sub>2</sub>粒子与液态 Ag 接触面积较大, 增加了银 熔池的粘度,从而降低了 Ag 的喷溅<sup>[22]</sup>。因此,材料表 面的烧蚀程度最小,燃弧时间最短,在多次电弧作用下 材料的燃弧时间能够保持在较小范围内波动。高的 SnO2含量造成 SnO2颗粒团聚严重,在电弧的反复作用 下,单根电弧易汇聚成较大的电弧,使电弧的移动性变 差,易于在某一位置长时间驻留,从而导致燃弧时间变 长。根据 SnO<sub>2</sub>颗粒团聚程度不同,电弧汇聚的大小也 不相同,造成了燃弧时间的长短不一致。此外,在电弧 的多次作用后,导致材料表面凹凸不平,一方面加剧了 材料表面的侵蚀程度,延长了燃弧时间,另一方面电弧 的热量部分消除了材料表面的毛刺和棱角,从而减轻了 材料的侵蚀, 缩短燃弧时间。电弧侵蚀过程中, 这 2 种情形同时发生,从而导致了燃弧时间波动。

#### 2.3 Ag-SnO<sub>2</sub> 触头材料电弧侵蚀形貌

图 3a~图 3d 是 SnO2 含量分别为 2%、4%、6%和 8%的 Ag-SnO2 触头材料 50 次真空电弧侵蚀后的表面 形貌,图 3a1~图 3d1 是触头材料表面电弧侵蚀中心形 貌,图 3a2~图 3d2 对应的是试样表面的典型侵蚀坑。 从图 3a 可以看出, SnO<sub>2</sub>含量为 2%时, Ag-SnO<sub>2</sub>触头 材料表面侵蚀面积大,蚀坑数量多,蚀坑很浅,分散 性强。从图 3a1 和图 3a2 可以看出,材料表面中心区 域的侵蚀形貌呈蜂窝状,无明显的液态金属喷溅痕迹。 与Ag-2%SnO2触头材料相比,Ag-4%SnO2触头表面蚀 坑加深,侵蚀面积减小,蚀坑数量也相应地减少,如 图 3b 所示。从图 3b1 和图 3b2 可进一步看出, Ag-4%SnO<sub>2</sub> 触头材料表面呈现凹凸不平的漩涡状形 貌。随 SnO<sub>2</sub>含量的增加,表面侵蚀进一步加剧,局部 出现了液态金属流动铺展的痕迹,表面电弧侵蚀不平 整加剧,见图 3c 和图 3d 所示。SnO<sub>2</sub>含量为 8%时, Ag-SnO<sub>2</sub> 触头电弧侵蚀最为严重,在材料表面出现大 量液态金属流动铺展的痕迹和液态金属凝固后形成的 旋涡状,局部还存在少量喷溅后产生的深坑,见图 3d, 图 3d1 和图 3d2 所示。这说明高的 SnO<sub>2</sub> 含量不利于 Ag-SnO2触头材料的耐电弧侵蚀性能的提高。

为了更确切地描述不同  $SnO_2$  含量的  $Ag-SnO_2$  触 头材料侵蚀表面的大小,采用 Image-Pro Plus 6.0 软件



图 2 不同 SnO<sub>2</sub>含量的 Ag-SnO<sub>2</sub>触头材料电弧侵蚀 50 次后的燃弧时间分布情况

Fig.2 Arcing duration of Ag-SnO<sub>2</sub> contact materials with different SnO<sub>2</sub> contents after arc erosion 50 times: (a) 2%, (b) 4%, (c) 6%, and (d) 8%



图 3 不同 SnO<sub>2</sub>含量的 Ag-SnO<sub>2</sub> 触头材料 50 次电侵蚀后的表面侵蚀形貌

Fig.3 Surface morphologies of Ag-SnO<sub>2</sub> materials with different SnO<sub>2</sub> contents after arc erosion 50 times: (a) 2%, (b) 4%, (c) 6%, (d) 8%; (a1~d1) central erosion regions; (a2~d2) typical erosion pits

对侵蚀面积进行了统计,结果如表 1 所示。随着 SnO<sub>2</sub> 含量增加,表面侵蚀区域逐渐减小。当 SnO<sub>2</sub> 含量从 2%增加到 8%时,侵蚀面积降幅达 41.1%。

为了进一步理解 Ag-SnO<sub>2</sub> 触头材料电弧侵蚀行 为,对 Ag-4%SnO<sub>2</sub> 触头材料边缘区域形貌进行了分 析,如图 4 所示。明显可以看出,电弧侵蚀发生在 SnO<sub>2</sub> 颗粒上,说明 Ag-SnO<sub>2</sub> 触头材料电弧侵蚀具有区域和 组元优先选择性。王亚平等<sup>[23]</sup>认为,电弧侵蚀通常在 逸出功低的组元上发生。由于 Ag 和 SnO<sub>2</sub> 的逸出功<sup>[24]</sup> 分别为 4.70 和 3.54 eV,因此 SnO<sub>2</sub> 更易首先被侵蚀。

对于 Ag-SnO<sub>2</sub> 触头材料,首次燃弧易于在弱击穿 相 SnO<sub>2</sub>发生。当阴极斑点熄灭,再次燃弧更易于在首 次燃弧区域周围的 SnO2发生,电弧从熄灭的弧根处跳 跃到新的弱击穿相再次燃弧,在 SnO<sub>2</sub> 颗粒上形成弧 根。SnO<sub>2</sub>含量增加使弱击穿相区域增大。随着侵蚀反 复进行,电弧不断熄灭和产生。由于电弧产生的热量 很大,Ag在电磁力和摩擦力的共同作用下发生气态蒸 发和液态喷溅,反复发生的液-固转变导致材料表面的 凸凹不平,形成更深的蚀坑。因此,高的 SnO<sub>2</sub>含量导 致侵蚀面积减小,侵蚀程度严重。其次,阴极斑点的 移动取决于侵蚀表面的结构。由于 Ag-SnO<sub>2</sub> 触头材料 电弧侵蚀优先发生在 SnO<sub>2</sub>颗粒上,所以 SnO<sub>2</sub>含量影 响侵蚀区域的大小。当 SnO<sub>2</sub> 颗粒均匀地分布在 Ag-SnO<sub>2</sub> 触头材料表面,电弧燃烧时,弧根对应的阴 极斑点之间距离减小, 弧根移动性好, 斑点跳动迅速, 电弧将在下一个位置继续产生,避免了集中烧蚀。因

表 1 不同 SnO<sub>2</sub>含量的 Ag-SnO<sub>2</sub>触头材料 50 次电弧侵蚀面积 Table 1 Arc erosion area of Ag-SnO<sub>2</sub> contact materials with different SnO<sub>2</sub> contents after arc erosion 50 times

SnO <sub>2</sub> content, $\omega/\%$	2	4	6	8
Area/mm <sup>2</sup>	9.464	8.144	7.219	5.578



图 4 Ag-4% SnO<sub>2</sub> 触头材料边缘区域侵蚀形貌

Fig.4 Arc erosion trace at the edge of Ag-4%SnO<sub>2</sub> contact material

此, SnO<sub>2</sub>含量较少的 Ag-SnO<sub>2</sub>触头材料表面侵蚀坑分 布较为均匀, 无明显的表面凸起以及较深的凹坑出现。 但是, 高的 SnO<sub>2</sub>含量易导致 SnO<sub>2</sub>颗粒团聚,随着电 弧侵蚀反复进行,单根电弧容易汇聚成大电弧,限制 了阴极斑点在 Ag 基体上的移动,导致电弧集中烧蚀, 产生深且大的侵蚀坑。此外,导热性也影响触头材料 的电弧侵蚀行为。电弧在形成过程中,需要触头材料 表面形成的金属蒸气来维持。导热性好,形成的金属 蒸气少,电弧燃烧到熄灭时间短,且电弧产生的热量 能及时地传导出去,导致金属熔池就难形成或熔池较 小。Ag-SnO<sub>2</sub>触头材料的导热性是由 Ag 和 SnO<sub>2</sub>来决 定的(Ag 的导热率为 418 J/m s K, SnO<sub>2</sub> 为 0.71 J/m s K)。根据 Ralyeigh 导热率公式<sup>[25]</sup>,

$$K_{\rm c} = K_{\rm m} \frac{1 + 2V_{\rm r} \cdot \frac{1 - k}{1 + 2k}}{1 - V_{\rm r} \cdot \frac{1 - k}{1 + k}}, (k = \frac{K_{\rm m}}{K_{\rm r}})$$
(1)

式中:*K*<sub>c</sub>为复合材料导热系数;*K*<sub>m</sub>为基体的导热系数; *K*<sub>r</sub>为第二相的导热系数;*V*<sub>r</sub>为第二相的体积分数。

可以看出,高的 SnO<sub>2</sub>含量导致 Ag-SnO<sub>2</sub>触头材 料的导热系数下降,致使电弧产生的热量不能及时散 发出去,更易造成触头表面形成金属熔池,加剧了表 面材料的蒸发和喷溅,从而在电弧反复的作用下出现 液态金属喷溅,留下了较大的蚀坑孔洞。

## 3 结 论

1) 随着 SnO<sub>2</sub> 含量增加, Ag-SnO<sub>2</sub> 触头材料平均 燃弧时间逐渐增加。

2) SnO<sub>2</sub>含量的增加,使得 Ag-SnO<sub>2</sub>触头材料表面 的电弧侵蚀面积减小,蚀坑变深,集中烧蚀程度增加。

3) Ag-SnO<sub>2</sub>触头材料电弧侵蚀具有区域选择性, 优先发生在 SnO<sub>2</sub>上。

#### 参考文献 References

- Fr éd éric P, Mohammed C. Proceedings of the 54th IEEE Holm Conference on Electrical Contacts[C]. New York: IEEE, 2008: 9
- [2] Kiyoshi Y, Sunao T. Proceedings of the 53rd IEEE Holm Conference on Electrical Contacts[C]. New York: IEEE, 2007: 134
- [3] Nilsson O, Hauner F, Jeannot D. 50th IEEE Holm Conference on Electrical Contacts and the 22nd International Conference on Electrical Contacts[C]. New York: IEEE, 2004: 70
- [4] Krätzschmar A, Herbst R, MüTzel T et al. Proceedings of the 56th IEEE Holm Conference on Electrical Contacts[C]. New

York: IEEE, 2010: 1

- [5] Jiang Fengyang(姜凤阳), Wang Junbo(王俊勃), Fu Chong(付 翀) et al. Rare Metal Materials and Technology(稀有金属材料与工程)[J], 2012, 41(8): 1443
- [6] Zhou Xiaolong(周晓龙), Chen Jingchao(陈敬超), Sun Jialin(孙加林) et al. The Chinese Journal of Nonferrous Metals(中国有色金属学报)[J], 2006, 16(5): 829
- [7] Liu X M, Wu S L, Chu P K et al. Materials Chemistry and Physics [J], 2006, 98(2): 477
- [8] Wang J, Li D, Wang Y. Journal of Alloys and Compounds[J], 2014, 582: 1
- [9] Liu L, Yan X, Weng W et al. 26th International Conference on Electrical Contacts[C]. Beijing: ITE, 2012: 362
- [10] Guo Fengyi(郭风仪), Wang Guoqiang(王国强), Dong Ne(董讷) et al. Proceedings of the CSEE(中国电机工程学报)[J], 2004, 24(9): 209
- [11] Du Yongguo( 堵 永国 ), Yang Guang( 杨 广 ), Zhang Jiachun(张家春) et al. Electrical Engineering Alloy(电工合 金)[J], 1997(4): 1
- [12] Ćosović V, Ćosović A, Talijan N et al. Journal of Alloys and Compounds[J], 2013, 567: 33
- [13] Wang Junbo(王俊勃), Liu Ying(刘英), Fu Chong(付翀) et al. Rare Metal Materials and Technology(稀有金属材料与工程)[J], 2009, 38(11): 2023
- [14] Wang Haitao(王海涛), Wang Jingqin(王景芹), Zhao Jingying(赵靖英) et al. Rare Metal Materials and Engineering(稀有金属材料与工程)[J], 2005, 34(10): 1666
- [15] Zhu Yancai(朱艳彩), Wang Jingqin(王景芹), Wang Haitao

(王海涛). Rare Metal Materials and Technology(稀有金属材料与工程)[J], 2013, 42(1): 149

- [16] Zhang Kunhua(张昆华), Guan Weiming(管伟明), Sun Jialin (孙加林) et al. Rare Metal Materials and Technology(稀有金 属材料与工程)[J], 2005, 34(6): 924
- [17] Liu Fangfang(刘方方), Chen Jingchao(陈敬超), Guo Yingchun(郭迎春) et al. Precious Metals(贵金属)[J], 2007, 28(3):
  24
- [18] Swingler J, Sumption A, Mcbride J W. Proceedings of the 51th IEEE Holm Conference on Electrical Contacts[C]. New York: IEEE, 2005: 346
- [19] Weaver P M, Pechrach K, McBride J W. IEEE Transaction on Components and Packaging Technology[J], 2004, 27(1): 51
- [20] Kharin S N, Nouri H, Davies T. Proceedings of the 48th IEEE Holm Conference on Electrical Contacts[C], New York: IEEE, 2002: 108
- [21] Wu Xixiu(吴细秀), Li Zhenbiao(李震彪). Proceedings of the CSEE(中国电机工程学报)[J], 2003, 23(6): 96
- [22] Gan Weiping(甘卫平), Li Jing(李 晶). Materials Science and Engineering of Powder Metallurgy(粉末冶金材料科学与工 程)[J], 2006, 11(5): 295
- [23] Wang Yaping(王亚平), Zhang Lina(张丽娜), Ding Bingjun (丁秉钧) et al. Proceedings of the CSEE(中国电机工程学 报)[J], 1999, 19(3): 46
- [24] Zhang Xianzhuo(张先桌). Principles of Transfer in Metallurgy (冶金传输原理)[M]. Beijing: Metallurgical Industry Press, 1988: 167
- [25] Beilis I. Applied Physics Letters[J], 2002, 81(21): 3936

## Arc Erosion Behavior of Ag-SnO<sub>2</sub> Contact Materials with Different SnO<sub>2</sub> Contents

Ren Weijia, Wang Xianhui, Zhang Miao, Yang Xiaohong, Zou Juntao (Xi'an University of Technology, Xi'an 710048, China)

**Abstract:** Ag-SnO<sub>2</sub> contact materials with different SnO<sub>2</sub> contents were prepared by powder metallurgy, and the effect of SnO<sub>2</sub> content on the arc erosion behavior of the materials was studied. The erosion surface morphology of Ag-SnO<sub>2</sub> contact materials were characterized by scanning electron microscope, and the factors influencing arc erosion were analyzed as well. The results show that the arc erosion prefers to occur on SnO<sub>2</sub> particles. With the SnO<sub>2</sub> content increasing, the arcing duration extends, the erosion area decreases and the erosion pits deepens, resulting in an obvious molten metal splash.

Key words: Ag-SnO<sub>2</sub> contact materials; powder metallurgy; erosion morphology; arc erosion

Corresponding author: Wang Xianhui, Professor, School of Materials Science and Engineering, Xi'an University of Technology, Xi'an 710048, P. R. China, Tel: 0086-29-82312185, E-mail: xhwang693@xaut.edu.cn